

106 年度「先進封裝設備計畫-推動產學合作建構工業基礎技術」計畫徵求公告

106.02.02 修訂

各位長官及學者教授，您好：

本專案計畫推動目標為遴選國內學術界中具高共通性、高技術規格、高產業擴散效益及具潛在應用市場之工業基礎技術，藉由本產學媒合平台進行先進封裝設備開發。本計畫將透過學界量能進行先進封裝設備設備領域相關之關鍵工業基礎技術研究，媒合產學技術合作開發，以協助國內業者解決供應鏈技術之缺口。

一、主管機關及執行機關：

本辦法之主管機關為經濟部工業局，執行機關為財團法人金屬工業研究發展中心。

二、計畫徵求範圍：

I. 先進封裝設備：

(1) 晶片檢取放置設備、(2) 貼合設備、(3) 光學檢測&缺陷檢測設備、(4) 高階鍍膜設備、(5) 次世代微影設備、(6) 蝕刻設備、(7) 研磨及薄化設備...等。

II. 先進封裝應用技術：

(1) 虛擬量測技術、(2) 自動化整合技術、(3) 最佳化系統模擬設計、(4) 區域 Pattern Fail 分析、(5) 先進自動化辨識系統、(6) AVM 技術...等。

三、徵求對象：

1. 申請機構:全國各公私立大專校院。
2. 計畫主持人資格:助理教授以上之專任教師。

四、申請及執行專案時程：

1. 申請截止：計畫公開徵求後開始接受申請，106 年 03 月 06 日(星期一)下午 6 時前完成申請作業(將完整構想書以電子郵件方式傳寄給聯繫窗口)。
2. 本專案計畫配合經濟部計畫時程，執行期程為七個月(106 年 04 月 01 日起至 106 年 10 月 31 號止)。

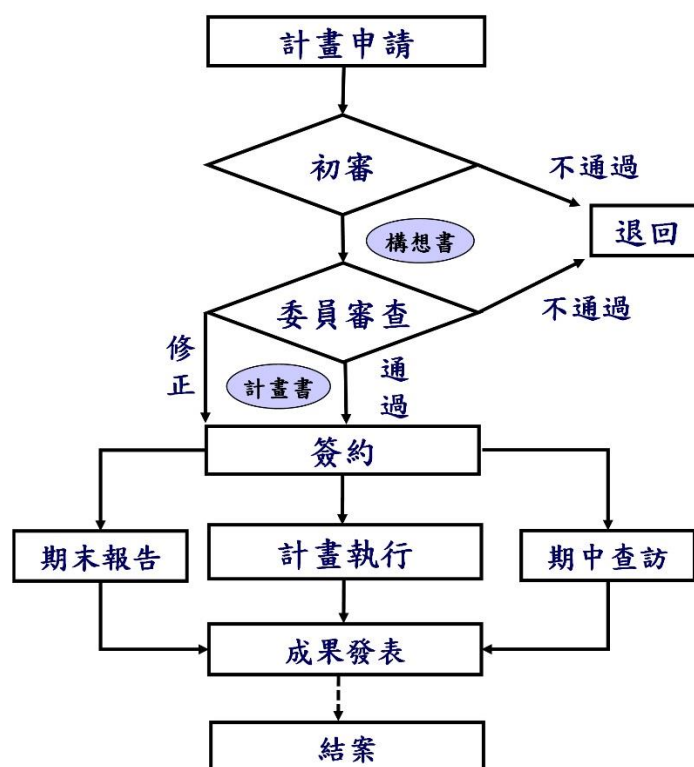
五、經費說明：

本計畫預算來源由經濟部工業局「先進封裝設備計畫」編列年度預算支應。提案單位於提案時編列計畫總經費，由審查委員調整並核定提案總經費，每案之申請經費上限金額為新臺幣 60 萬元。

六、專案計畫申請資格：

1. 本專案計畫由學界洽詢合作廠商開發意願，採直接「研提具廠商合作同意書之完整構想書」進行申請，合作廠商之資格限定及相關進行時程分述如下。
2. 廠商資格須符合：
 - (A) 依公司法設立之民營製造業(需有工廠登記證)或先進封裝產業相關之技術服務業。
 - (B) 申請公司或其負責人均非銀行拒絕往來戶，且其對主管機關違約之舊案財務無責任未清者。
 - (C) 申請公司實收資本額超過(含)新台幣 2,000 萬元。
 - (D) 申請公司無欠繳應納稅捐情事。
3. 本專案計畫受理期限與計畫相關資訊將公告於計畫辦公室網站 (http://www.mirdc.org.tw/news/News01_detail.aspx?Type=0&cond=1633&Source=0&sty=02)。
4. 完整構想書格式(如附件一)依規定辦理，文件不全或不符合規定者不予受理。
5. 台灣企業已能自主開發或販售之技術相近開發計畫，將不獲得推薦。
6. 本專案計畫將遴聘業界專家，成立專業審查委員會，進行計畫書審查作業，依審查分數高低擇優錄取開發案共 4 案(含)。

7. 全程作業流程



七、專案計畫聯絡資訊：

光電及半導體設備產業發展計畫：

主持人：吳春森 處長(財團法人金屬工業研究發展中心)

聯繫窗口：張瑋才 博士

聯絡電話 (07) 695-5510#357

E-mail：wtc1013@mail.mirdc.org.tw